

有研半导体硅材料股份公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

股票简称：有研硅

股票代码：688432

2025 年 11 月

有研半导体硅材料股份公司

会议资料目录

一、股东会须知

二、会议议程

三、会议议案

1、议案一：《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案》

2025 年第三次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《有研半导体硅材料股份有限公司章程》《有研半导体硅材料股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14:00

召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票人员
- (五) 审议以下议案

- 1、 审议《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计现场表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果
- (十) 见证律师出具股东会见证意见
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 宣布现场会议结束

议案一：

关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案

各位股东和股东代表：

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”或“有研硅”）拟将“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”中一部分资金 11,922 万元用于新建“集成电路用 8 英寸硅片再扩产项目”，原“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月；新建项目预计完成时间为 2026 年 12 月。具体情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）实际募集资金到账和使用情况

1、实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047 号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,714.3158 万股，每股发行价格为 9.91 元，募集资金总额为人民币 185,458.87 万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币 166,396.72 万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 7 日出具《验资报告》（毕马威华振验字第 2201588 号）。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计使用募集资金 100,056.36 万元，截至 2025 年 9 月 30 日，本年度实际使用募集资金 14,121.37 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金余额为 57,046.76 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专项账户余额为 3,046.76 万元，与募集资金余额相差 54,000.00 万元均为未到期的现金管理余额。

（二）募集资金的管理

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司（以下简称“山东有研半导体”）已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议对本公司（及子公司）、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2025 年 9 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行名称	银行账号	金额
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	781.15
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	184.23
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	1,170.27
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	93.37
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	817.74
合计		3,046.76

（三）募投项目基本情况

根据《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说

明书》《有研半导体硅材料股份公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》，截至 2025 年 9 月 30 日公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金	项目达到预定可使用状态日期
1	集成电路用 8 英寸硅片扩产项目	山东有研半导体	384,824,300.00	384,824,300.00	2025 年 12 月
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	山东有研半导体	357,347,600.00	357,347,600.00	2025 年 12 月
3	补充研发与运营资金	有研硅	257,828,100.00	257,828,100.00	不适用
合计			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	/

截至 2025 年 9 月 30 日，募投项目（包括补充研发与运营资金）实际完成投资 717,925,626.96 元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）
1	集成电路用 8 英寸硅片扩产项目	384,824,300.00	300,763,566.50	78.16
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	357,347,600.00	169,707,553.01	47.49
3	补充研发与运营资金	257,828,100.00	247,454,507.45	95.98
合计		1,000,000,000.00	717,925,626.96	71.79

二、此次变更募集资金投资项目的概述

公司拟调整“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”实施方案，拟将“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”中一部分资金 11,922 万元（占实际募集资金净额的

7.16%) 用于新建“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”，并将原“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”的预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。新建“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”预计建成时间为2026年12月。本次变更后，募集资金投资计划如下：

单位：元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金	项目达到预定可使用状态日期
1	集成电路用 8 英寸硅片扩产项目	山东有研半导体	384,824,300.00	384,824,300.00	2025 年 12 月
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	山东有研半导体	238,127,600.00	238,127,600.00	2026 年 12 月
3	集成电路用 8 英寸硅片再扩产项目	山东有研半导体	119,220,000.00	119,220,000.00	2026 年 12 月
4	补充研发与运营资金	有研硅	257,828,100.00	257,828,100.00	不适用
合计			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	/

公司本次调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。本事项不涉及关联交易。

董事会认为：本次调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的事项是公司根据市场需求变化和实际经营发展，综合考虑公司发展规划和布局做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，优化公司资源，进一步保障募集资金投资项目的顺利实施。董事会同意该事项。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金总额	185,458.87
募集资金净额	166,396.72
募集资金到账时间	2022 年 11 月 7 日
涉及变更投向的总金额	11,922.00

涉及变更投向的总金额占募集资金净额比例	7.16%
改变募集资金用途类型	☒ 改变募集资金投向 ☒ 改变募集资金金额 ☐ 取消或者终止募集资金投资项目 ☐ 改变募集资金投资项目实施主体 ☐ 改变募集资金投资项目实施方式 ☒ 实施新项目 ☐ 永久补充流动资金 ☐ 其他：_____

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目							变更后募投项目						
项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	截止 2025 年 9 月 30 日，已投入金额	是否已变更项目，含部分变更	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	山东有研半导体	山东省德州市经济技术开发区尚德八路 3998 号	35,734.76	35,734.76	35,734.76	16,970.76	拟变更	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	山东有研半导体	山东省德州市经济技术开发区尚德八路 3998 号	23,812.76	23,812.76	否
								集成电路用 8 英寸硅片再扩产项目	山东有研半导体	山东省德州市经济技术开发区尚德八路 3998 号	11,922.00	11,922.00	否

三、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）调整“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”的情况

1、原募投项目计划和实际投资情况

“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”于 2021 年 7 月 7 日立项，原计划投资总额为 35,734.76 万元，拟使用募集资金 35,734.76 万元，其中：建设投资 32,799.74 万元，铺底流动资金为 2,935.02 万元，无建设期利息。本项目建成后将实现新增集成电路刻蚀设备用硅材料产能 90 吨/年，项目实施主体为山东有研半导体。

项目投资构成情况如下：

单位：万元

序号	工程项目和费用名称	计划投资额	占项目总投资的比例（%）
1	建设投资	32,799.74	91.79
1.1	建筑工程费	5,056.20	14.15
1.2	设备及软件购置费	24,492.40	68.54
1.3	工程建设其他费用	1,689.24	4.73
1.4	预备费	1,561.89	4.37
2	铺底流动资金	2,935.02	8.21
合计		35,734.76	100.00

项目原计划 2024 年 11 月达到预定可使用状态，2024 年 4 月 26 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》将项目延期至 2025 年 12 月。截至 2025 年 9 月 30 日，该项目累计投入 169,707,553.01 元，投入进度 47.49%。

2、募投项目实施方案调整情况

（1）项目总投资由 35,734.76 万元调减至 23,812.76 万元，调减金额 11,922.00 万元。调整后总投资 23,812.76 万元，调整后预计于 2026 年底实现项目目标。本次调整后项目投资构成情况具体如下：

单位：万元

序号	调整后			
	工程项目和费用名称	项目投资总额	拟使用募集资金	占项目总投资的比例（%）
1	建设投资	22,515.99	22,515.99	94.55
1.1	建筑工程费	8,581.55	8,581.55	36.04
1.2	设备及软件购置费	11,496.19	11,496.19	48.28
1.3	工程建设其他费用	2,217.83	2,217.83	9.31
1.4	预备费	220.42	220.42	0.93
2	铺底流动资金	1,296.77	1,296.77	5.45
合计		23,812.76	23,812.76	100.00

(2) 项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月调整至 2026 年 12 月。

(二) “集成电路刻蚀设备用硅材料项目”方案变更的具体原因

1、原项目拟定原因

鉴于募投项目立项初期，大直径单晶及其加工产品市场需求的快速增长，公司产能无法满足市场与客户的需求，公司紧抓市场机遇，适时开展“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”。

2、市场及行业形势的变化

近年来大直径单晶市场整体需求呈现疲软态势，产品价格下行，产业链各环节库存压力较大，订单量不及预期，产能利用率出现阶段性下调。与此同时，受中美贸易战影响，刻蚀材料出口规模显著下滑，部分下游客户向产业链上游延伸，开展刻蚀材料自主生产，导致市场份额受到一定程度挤压。

3、项目变更及延期原因

基于对当前市场环境的深入分析，结合公司发展战略，经过审慎研判，公司拟调整“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”的投资总额及可使用状态日期。该募投项目预计于 2026 年底实现项目目标，公司将优先推进对应产能的市场开拓，确保已有产能充分利用。后续扩产计划将视市场行情稳步实施，以此动态优化资源配置，最大化投资效益，从而增强公司盈利能力和市场竞争力。

四、“集成电路用 8 英寸硅片再扩产项目”的具体内容

（一）项目基本情况及投资计划

1、项目名称：集成电路用 8 英寸硅片再扩产项目

2、实施主体：山东有研半导体材料有限公司

3、项目地址：山东省德州市经济技术开发区尚德八路 3998 号

4、新增项目建设内容：本项目在山东有研半导体现有厂房内新增设备及信息系统 46 台套，建成后新增 8 英寸硅片产能 5 万片/月。

5、项目投资计划：本项目计划总投资 11,922.00 万元，其中：建设投资 11,114.00 万元，铺底流动资金为 808.00 万元，无建设期利息。项目投资构成情况具体如下：

单位：万元

序号	工程项目和费用名称	拟投资额（万元）	占项目总投资的比例（%）
1	建设投资	11,114.00	93.22
1.1	设备购置费	10,310.00	86.48
1.2	软件购置费	300.00	2.52
1.3	二次配工程	504.00	4.23
2	铺底流动资金	808.00	6.78
项目总投资		11,922.00	100.00

6、项目建设周期：预计于 2026 年 12 月达到项目可使用状态。

（二）项目可行性分析

1、项目背景情况

随着 5G 通信、人工智能及新能源汽车等新兴产业的增长，对半导体产品的需求持续攀升，尤其是在射频芯片、逻辑芯片、存储芯片和电机驱动芯片等领域需求快速增长。根据 QY Research 预测，中国作为全球最大的半导体消费市场，预计到 2035 年其市场规模将突破 3.5 万亿元。硅材料作为主流的半导体材料，全球年复合增长率为 6-8%，国内年复合增长率为 10-12%（复合增长率为近 5 年平均数据，数据来源 QY Research、中商情报网），整体市场规模不断扩大。

在国家政策、资金持续支持的作用下，叠加地缘政治影响，国内半导体产业格局正在加速重建，半导体硅材料的全面国产化进程进一步加快。目前，国内市

场 8 英寸轻掺片和区熔片国产化率仍处于较低水平，国产替代空间广阔。公司 8 英寸硅片产能预计于 2025 年末达到 25 万片/月，后续通过 8 英寸硅片再扩产，将再新增产能 5 万片/月，可更好地满足市场需求。在保持公司重掺产品优势的同时，提升轻掺、区熔产品的产能和规模，紧抓国产替代和增量市场的机会，进一步提升市场份额，增加公司产品交付能力和整体盈利能力，符合公司既定的硅片产能战略规划。

2、项目可行性分析

（1）国家层面的战略引领与政策支持，为项目实施提供了坚实保障。

国家“十四五”规划明确将半导体材料列为攻关重点，期间国内半导体硅材料和零部件产业取得了长足进步，为后续发展奠定了坚实基础。步入“十五五”是全面实现半导体材料国产化的战略机遇期，国际环境、国内政策将持续利好半导体硅片产业发展。有研硅作为长期深耕集成电路硅材料领域的企业，持续致力于先进制程用半导体硅材料技术的研发和产业化，以响应国家战略与产业需求。在此背景下，公司进一步扩大 8 英寸硅片产能，与其整体战略规划高度契合。

（2）公司具备领先的技术实力与丰富的产品体系，为项目落地提供了核心支撑。

公司自成立以来，始终专注于半导体单晶硅材料的研发、生产与销售，是国内 8 英寸硅片领域的先行者。通过突破并优化多项关键工艺，公司构建了坚实的技术壁垒，掌握了晶体原生缺陷控制、背封与多晶硅沉积、硅片贴蜡抛光及清洗等核心专利技术。这些先进技术不仅保障了产品的高良品率，也有效降低了生产成本。

公司 8 英寸硅片产品覆盖面广、品类齐全，包括红磷超低阻硅片、MCZ 硅片、轻掺片、区熔片等多个品类，并已实现全面量产，能够充分满足下游客户的多样化需求，其产品性能与技术实力荣获“中国半导体创新产品”、中国有色金属工业科技奖等权威认定，为本项目的落地提供核心支撑。

（3）公司拥有长期稳定的客户资源，为项目推进提供了市场保障。

公司所处的集成电路先进制造行业，对产品质量、精细控制有较高要求，客户认证周期长、标准严苛。作为国内 8 英寸硅片领域的先行者，公司凭借“技术领先、质量可靠、诚信进取、客户满意”的质量方针，在业内形成了较高的品牌知名度，并拥有稳定的核心客户群，为本项目市场开拓奠定了基础。

(4) 项目实施具有重要战略意义，加快推动国产替代，同时增强供应链安全性和可控性。

根据相关数据统计，目前国内 8 英寸轻掺硅片与区熔硅片的国产化率还有待提高，高端市场仍依赖进口，供应链自主可控需求迫切。在此背景下，本项目瞄准国产替代的战略机遇，通过引入 COP-free 拉晶技术、表面平整度和缺陷控制技术等关键技术，旨在实现高端 8 英寸硅片的规模化量产。这不仅将直接提升关键材料的国产化率，更能有效降低下游重要客户的供应链风险，助力国家集成电路产业的稳健发展。

(三) 项目必要性分析

1、强劲的市场需求，推进项目落地实施。

面对持续增长的半导体硅材料市场需求，公司以“成为世界一流半导体企业”为目标，将发展 8 英寸及以上硅片产业确立为核心战略目标。通过持续完善产业化生产、加速新产品开发与优化产能布局，巩固在 8 英寸特色硅片领域的技术领先地位，强化差异化竞争优势，不断扩大市场份额，从而进一步提升企业核心竞争力。

2、有效填补产能缺口，助力企业营收增长。

到 2025 年末，公司 8 英寸硅片产能将达到 25 万片/月。为进一步提高轻掺片和区熔片的交付能力，公司计划通过“集成电路用 8 英寸硅片再扩产项目”，再新增 8 英寸硅片产能 5 万片/月。项目投产后，可有效缓解产能不足的问题，进一步巩固公司在关键细分市场的供应保障能力，为未来的业务增长奠定坚实基础。

3、加速提升技术水平，驱动产品结构优化。

本项目计划引入包括低缺陷晶体生长、高品质区熔单晶、高精度抛光在内的核心先进工艺，以满足逻辑芯片、传感器件、IGBT 功率器件、射频器件等产品的需求。通过技术升级将助力公司产品结构的优化，为提升毛利率和整体盈利水平提供强劲的增长动力。

(四) 项目经济效益分析

项目的顺利实施将有助于公司扩大收入规模，提高公司产品的市场占有率和盈利能力，带来显著的经济效益。根据测算，在实现预期投入产出的前提下，项目税后内部收益率处于良好区间，动态投资回收期合理，各项关键财务指标稳健，

项目具备经济可行性。

五、项目的市场前景和风险提示

（一）宏观经济风险及控制措施

当前，公司面临全球宏观经济复苏乏力与地缘政治冲突交织带来的外部不确定性，终端电子产品需求疲软通过产业链传导至上游，抑制了对半导体硅片的需求；同时汇率波动加剧也对企业出口竞争力与成本控制构成压力。在国内方面，经济结构性调整与社会投资意愿不足可能延缓芯片制造环节的扩产节奏，进而影响硅片需求增长。为应对上述风险，公司将采取以下措施：一是定期开展市场调查，结合市场变化情况，动态调整优化发展目标。二是实施多元化市场布局，积极推进全球化与区域化并进的市场战略，在巩固已有市场的同时，积极拓展受经济周期影响较小的高附加值特色产品领域，不断提高市场占有率，分散系统性风险。三是深耕航空航天、国防科技、高端医疗设备、自动驾驶感知系统等所需的高可靠性、特种规格的硅片产品。这些领域虽然认证周期长，但一旦进入则优势显著：供应链稳定、客户对价格敏感度较低、抗经济周期能力强，能显著增强公司的盈利稳定性和整体韧性。

（二）行业风险及控制措施

半导体具有显著的周期性及经济发展态势关联性，在经济下行时期，消费电子等终端市场需求可能出现萎缩，导致芯片厂商会削减订单、降低产能利用率，从而直接导致对硅片的需求下降。这种周期性波动可能影响本项目的建设进度和预期效益。此外，行业面临激烈的市场竞争与格局风险，国内厂商众多，价格竞争现象较为普遍，可能对项目产品的市场开拓和盈利水平带来挑战。为有效应对行业风险，公司将采取以下措施：一是加强产品差异化和定制化能力，通过多元化布局平滑整体业绩波动；二是强化技术服务协同，积极参与未来技术竞争，构建技术壁垒赢得客户；三是通过实施精益管理，降低库存、提升资金周转率与盈利能力。

（三）产能过剩风险及控制措施

若市场需求不足，产能规划过大，项目完成后产能无法完全释放，本项目可能面临产能过剩风险，导致产品滞销、库存积压、固定成本增加，压缩利润空间。为应对上述风险，公司将紧跟行业发展趋势和市场需求变化，不断完善产业化生

产，加快新产品开发和合理布局产能，保持 8 英寸硅片特色产品技术领先，提升差异化竞争优势，巩固和提升市场占有率，进一步提升企业核心竞争力。

（四）技术风险及控制措施

本项目在技术层面可能面临以下风险：一是 8 英寸硅片关键技术不成熟，工艺路线复杂难以量产；二是关键技术依赖外部，创新能力不足导致高品质低成本技术更新迭代速度不能满足市场要求。为有效管理技术风险，公司将采取以下措施：一是项目将引入低缺陷晶体生长、高品质区熔单晶、高精度抛光工艺，以满足逻辑芯片、传感器件、IGBT 功率器件、射频器件等高端需求。二是在前期充分进行技术评估和验证，优先选择技术成熟度较高的方案；加强技术研发与验证，建立技术备份，为关键技术节点准备替代方案；持续跟进技术发展趋势，设置技术研发评审机制，对技术进展进行严格评估，及时决策是否继续或转向；通过申请专利、技术秘密保护等方式构建自身的技术壁垒。

六、项目所涉及的备案等程序

公司已取得相关备案文件，备案手续齐全。

七、本次调整部分募投项目实施方案及部分募投项目延期暨新增募投项目对公司的影响

公司本次调整部分募投项目实施方案及部分募投项目延期是基于公司实际业务发展需求作出的审慎决定，未改变募投项目实施主体。本次新增“集成电路用 8 英寸硅片再扩产项目”有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营发展的需要。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《有研硅关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的公告》。本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025 年 11 月 12 日